

IoT市場拡大に資する 半導体産業の進展とコア技術とは？

Progress in the semiconductor industry contributing to expanding IoT market and what are core technologies ?

2024年3月22日（金） 13:30～17:00

東京都市大学 世田谷キャンパス & オンライン

IoT（モノのインターネット）では、データ収集にセンサを搭載したアナデジ混載LSIの使用が想定され、センサを高度化させるプロセス技術や、センサとLSIの集積化に適した実装技術が重要である。端末の小型化や長時間動作などIoTの適用範囲の拡大に資する半導体産業の進展とコア技術について議論する。

●招待講演（5件）

森川 泰宏 アルバック株式会社
AI・IoT時代に向けた3D・チップレット集積技術の開発



竹井 裕介 産業技術総合研究所
極薄圧電MEMS素子による
双方向リモート触覚伝達AIシステムの開発



鈴木 裕輝夫 東北大学
シリコンマイグレーションシール（SMS）
ウェハレベル高真空封止技術



徳田 崇 東京工業大学
IoE（Internet of Everything）を目指した光駆動マイクロ
エッジによる非エレクトロニクス物の情報化



西山 高浩 ローム株式会社
エッジデバイス向けオンデバイス学習AIアクセラレータ
とCPUコアの開発



●一般講演（数件募集中）

企画 : 集積化MEMS技術研究会 (<http://annex.jsap.or.jp/MEMS/>)
世話人 : 島村俊重(NTT)、後藤正英(NHK)、岡本有貴(産総研)
お問合せ : toshishige.shimamura@ntt.com